

EM-Tec メタルおよびカーボンパウダー

導電性包埋材作成用 高純度メタルパウダー



イントロダクション

EM-Tec メタルパウダーは、主に樹脂、エポキシ、シアノアクリレート接着剤、およびその他の包埋材料と混合して、導電性包埋材を作成することを目的としています。金属組織断面測定で断面を作成する場合、またはFIB準備を使用する場合、不規則な形状のサンプルの包埋が必要です。導電性包埋は導電性コーティングの必要性をなくし、帯電効果なしにエッジを分析できるため、SEM/FIBアプリケーションに有効です。グラファイト粉末の導電性カーボンは、ほとんどの樹脂の密度と互換性があり、銅粉末は粘性で速硬化性の樹脂により適しています。

メタルパウダー仕様

| 材質 | 元素記号 | サイズ | 純度 | パッケージ |
|---------------|------|-------------------|--------|------------|
| カーボン (グラファイト) | C | approx. 5 μ m | 99.9 % | 25g / 60ml |
| 銅 | Cu | < 50 μ m | 99.99% | 50g / 30ml |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|  | EM-Tec 銅パウダー 500 メッシュ(<50μm 粒径) 純度 99.99% 50g | | |
| パーツ番号 | 数量 | 価格 | |
| 70-CU0029 | 1本 | ¥6,500 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--|
|  | EM-Tec グラファイト パウダー 粒径 5μm 純度 99.9% 25g | | |
| パーツ番号 | 数量 | 価格 | |
| 70-CC0006 | 1本 | ¥6,500 | |